



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 936—2013

集成电路器件用镍钒合金靶材

Sputtering nickel vanadium alloy target used in integrated circuit device

2013-10-17 发布

2014-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准负责起草单位:有研亿金新材料股份有限公司。

本标准参加起草单位:北京有色金属研究总院、宁波江丰电子材料股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准主要起草人:董亭义、何金江、刘红宾、张涛、姚力军、王学泽、向磊、徐学礼、朱晓光、丁照崇、吕超、雷继峰、熊晓东、张殿凯、李娜。

集成电路器件用镍钒合金靶材

1 范围

本标准规定了集成电路器件用镍钒合金溅射靶材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同或订货单内容。

本标准适用于电子薄膜制造用的各类镍钒合金溅射靶材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1031 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T 6394 金属平均晶粒度测定法

GB/T 14265 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

GJB 1580A 变形金属超声检验方法

YS/T 837 溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

靶材 target

溅射沉积技术中的阴极部分。该阴极材料在带正电荷的阳离子撞击下以分子、原子或离子的形式脱离阴极而在阳极表面沉积。

3.2

靶坯 target blank

阴极上用作目标材料的部分。

3.3

背板 backing plate

用来支撑或固定靶坯的部分。靶材与背板可以通过焊接(如钎焊、电子束焊、扩散焊等)、机械复合、粘接等方式连接。

4 要求

4.1 产品分类

4.1.1 按照结构形式分为单体和复合两种,如图 1 所示。